高出力半導体素子における高放熱構造を実現するウェハ常温接合技術

日暮　栄治 *，須賀　唯知 *

Room-Temperature Wafer Bonding for High-Heat Dissipation Structure in High-Power Semiconductor Devices

Eiji HIGURASHI* and Tadatomo SUGA*

* 東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻（〒 113-8656　東京都文京区本郷 7-3-1）
*Department of Precision Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo (7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656)